



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO**

CONSULTA PÚBLICA Nº 05, DE 4 DE MARÇO DE 2015.

O Secretário do Desenvolvimento da Produção do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, de acordo com os artigos 8º e 9º da Portaria Interministerial MDIC/MCT nº 170, de 4 de agosto de 2010, torna pública a proposta de alteração das Portarias Interministeriais nºs 43 e 44, de 14 de fevereiro de 2013, que estabelecem o Processo Produtivo Básico – PPB para **BENS DE INFORMÁTICA**.

O texto completo está disponível no sítio da Secretaria do Desenvolvimento da Produção, no endereço:

<http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=2&menu=3335>

As manifestações deverão ser encaminhadas no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data de publicação desta Consulta no Diário Oficial da União, a todos os seguintes *e-mails*: cgel.ppb@mdic.gov.br, mcti.ppb@mct.gov.br e cgapi@sufama.gov.br.

CARLOS AUGUSTO GRABOIS GADELHA
Secretário do Desenvolvimento da Produção

ANEXO

PROPOSTAS N^{os} 041/13, 043/13, 062/13, 070/13, 001/14, 039/14 e 053/14 – ALTERAÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO BÁSICO DE BENS DE INFORMÁTICA, FIXADO ATUALMENTE PELAS PORTARIAS INTERMINISTERIAIS N^{os} 43 e 44, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2013:

Obs.: A Consulta está na forma de Portaria (versão Lei de Informática)

Art. 1º O Processo Produtivo Básico para os BENS DE INFORMÁTICA, estabelecido pela Portaria Interministerial MDIC/MCTI nº 43, de 14 de fevereiro de 2013, passa a ser o seguinte:

I - montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso;

II - montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e

III - integração das placas de circuito impresso e das demais partes elétricas e mecânicas na formação do produto final, montadas de acordo com os incisos I e II acima.

§ 1º Desde que obedecido o Processo Produtivo Básico, as atividades ou operações inerentes às etapas de produção poderão ser realizadas por terceiros, no País, exceto a etapa descrita no inciso III que não poderá ser objeto de terceirização.

§ 2º Quando o BEM DE INFORMÁTICA a que se refere esta Portaria não contiver placas de circuito impresso com componentes montados, a etapa constante do inciso I poderá ser dispensada, permanecendo obrigatórias as demais etapas.

§ 3º As FONTES DE ALIMENTAÇÃO, CONVERSORES DE CORRENTE CONTÍNUA (CA-CC) OU CARREGADORES DE BATERIA, quando forem externas ou quando estiverem contidas no mesmo corpo ou gabinete de um BEM DE INFORMÁTICA, deverão ser produzidos atendendo às etapas estabelecidas no caput deste artigo, num percentual mínimo de 80% (oitenta por cento), tomando-se por base a quantidade total produzida, no ano-calendário.

§ 4º As placas de interfaces de comunicação com tecnologia sem fio, destinadas aos BENS DE INFORMÁTICA, deverão ser produzidas atendendo às etapas estabelecidas no caput deste artigo, num percentual mínimo de 80% (oitenta por cento), tomando-se por base a quantidade total produzida, no ano-calendário.

§ 5º Caso os percentuais estabelecidos nos parágrafos 3º e 4º não sejam alcançados no período previsto, a empresa ficará obrigada a cumprir a diferença residual, em unidades produzidas, até 31 de dezembro do ano seguinte, sem prejuízo das obrigações correntes.

§ 6º A diferença residual a que se refere o § 5º não poderá exceder a 10% (dez por cento), tomando-se por base a produção do ano em que não foi possível atingir o limite estabelecido.

Art. 2º Ficam temporariamente dispensados de montagem os seguintes módulos ou subconjuntos:

1. Banco de martelos para impressoras de linha
2. Cabeça de impressão térmica
3. Conjunto de espelhos e conjunto óptico para leitor de código de barras
4. Gabinete superior com visor de vidro destinado à fabricação de leitor de código de barras vertical, fixo, do tipo mesa ou balcão
5. Mecanismo impressor com largura de impressão de até 6 (seis) cm
6. Mecanismo impressor e leitor de cartão magnético para dispensadores automáticos de papel-moeda - <i>cash dispenser</i> ou terminal de autoatendimento ATM (<i>Automatic teller machine</i>)
7. Mecanismo impressor/leitor motorizado de bilhete magnético
8. Mecanismo para aparelhos de fac-símile com impressão por sistema térmico ou a laser, mecanismo para aparelhos digitalizadores de imagens - scanner, mecanismo para aparelhos digitalizadores de imagens - scanner utilizado em subconjuntos depositários de cheques e envelopes.
9. Mecanismo para impressora a laser, LED - Diodos emissores de luz ou LCS - Sistema de cristal líquido - <i>engine</i>
10. Microprocessador montado em placa com barramento de conexão à placa mãe com mais de duzentas vias, condicionadas ou não em cartucho
11. Modulador/demodulador de rádio frequência denominado <i>tuner</i>
12. Módulo SOM (<i>System on module</i>) com circuito lógico e/ou de rádio frequência integrado próprio para conexão à placa de circuito impresso através de processo de montagem por superfície – SMT (<i>Surface Mounted Technology</i>)
13. Módulo de comunicação Bluetooth próprio para conexão à placa de circuito impresso através de processo de montagem por superfície - SMT (<i>Surface Mounted Technology</i>)
14. Módulo display de cristal líquido - LCD, com placa de controle integrada
15. Módulo GPS - Sistema de posicionamento global
16. Módulo leitor de cartão inteligente - <i>smart card</i>
17. Módulo leitor de código de barras para terminais de autoatendimento
18. Módulo, dispositivo ou subconjunto de mostrador de cristal líquido, plasma ou diodo emissor de luz - LED e outras tecnologias de displays
19. Módulo sensor de proximidade
20. Módulo Sensor Biométrico
21. Módulo Sensor Sísmico
22. Módulo tiristor simétrico de potência, tipo SGCT (<i>Symmetrical Gate Commutated Thyristors</i>), com características técnicas de 6.500 V e 400-800A, para utilização em Inversor de Frequência de Média Tensão
23. Padrão de grandezas elétricas e sensor fotoelétrico para aquisição de pulsos
24. Painel de operação e controle para impressoras, mesmo incorporando dispositivo de visualização
25. Placa de circuito impresso montada com componentes elétricos ou eletrônicos que implemente função de processamento central, do tipo industrial, que suporte temperaturas de operação superiores a 60º C, para utilização em sistemas de medição de energia elétrica
26. Teclado e visor para aparelhos de fac-símile
27. Tubo de raios catódicos policromático, mesmo com bobina de deflexão e dispositivos de ajuste de convergência incorporados
28. Tubo de raios catódicos policromático, mesmo com bobina de deflexão, dispositivos de ajuste de convergência e transdutores com cabo de comunicação incorporados, para monitores de vídeo com tela tipo <i>touch screen</i>
29. Unidade de fita magnética tipo DAT - Fita digital de áudio

30. Subconjunto óptico montado destinado às unidades de saída por vídeo, para máquinas automáticas para processamento de dados, com tecnologia de micro espelho e processador digital de luz, contendo disco de cores do tipo Disco de Newton, lâmpada ou LCD ou LED, lentes e espelhos ópticos.
31. Placa de circuito impresso montada com componentes elétricos ou eletrônicos que implemente a função de transmissão e recepção de sinais infravermelhos em monitores de vídeo igual ou acima de 40" com função de tela sensível ao toque.
32. Unidade de disco magnético.
33. Unidade de disco óptico.
34. Módulo de diodo a laser destinado a aparelho eletro médico para cirurgia via emissão a laser.
35. Módulo sensor de imagem destinado a leitores automático de cheques e documentos, com/sem leitor de códigos de barras e de <i>smart card</i> com/sem impressão <i>inkjet</i> .
36. Módulo controlador de carga de acumuladores elétricos, com faixa de temperatura de operação que suporte a variação mínima de -40°C a +60°C e capacidade de operação em ambientes com umidade relativa de 100%.
37. Módulo de carga por aproximação para acumulador elétrico, com tecnologia de indução eletromagnética, quando acompanhado do carregador/conversor CA/CC que cumpra o PPB vigente, limitado a 1.000 (um mil) unidades anuais por grupo econômico.
38. Mecanismo do pedestal composto de cilindro a gás de alta pressão, com a função de elevação, suporte de fixação e/ou sustentação, submecanismos de giros e inclinação para tela (display), limitado a 5.000 (cinco mil) unidades anuais por grupo econômico.
39. Módulo de laser CO2 cavidade em tubo 100% metal e selado, com fonte de energia de rádio frequência (RF), destinado a aparelho eletromédico para cirurgia via emissão laser.

§ 1º As dispensas constantes dos itens 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29 e 31 do caput se aplicam até 1º de julho de 2015.

§ 2º As dispensas constantes dos itens 36 e 37 do caput se aplicam até 31 de dezembro de 2016.

Art. 3º Sempre que fatores técnicos ou econômicos, devidamente comprovados, assim, o determinarem, a realização de qualquer etapa do Processo Produtivo Básico poderá suspensa temporariamente ou modificada, por meio de portaria conjunta dos Ministros de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e da Ciência, Tecnologia e Inovação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Fica revogada a Portaria Interministerial MDIC/MCTI nº 43, de 14 de fevereiro de 2013.